

四川省电子学会SMT专委会

川电会 SMT 专委会[2019] 03

关于举办 2019 中国高端 SMT 学术会议（第十三届）

征文通知

坚持创新是引领行业发展的第一动力，为响应国家创新驱动发展战略，聚焦西部电子行业的崭新前景，四川省电子学会SMT专委会拟定于2019年10月23日在四川省成都市召开“第十三届中国高端SMT学术会议”。

该会议在全国各地已经连续举办了十二届，会议聚集了行业顶尖的专家、学者、在线工程技术人员等，重点探讨电子智能制造技术及发展方向，对推动我国电子技术的创新与发展，起到了积极的促进作用。

会议将汇聚国内外SMT业界专家、学者、工程技术人员、制造管理人士、商业贸易友人，为SMT业界提供一个更为广阔的信息交流、合作共赢的平台，共同推动我国电子制造业的进步。围绕丝印、贴片、焊接、印制板和焊盘设计、焊点质量、检测与返修、检测标准、机器人自动化、材料选择、设备改造、清洗、设备防护、自动化、管理等方面开展学术技术研讨和交流。

一、征文范围：

本次高端 SMT 学术会议诚征与表面贴装工艺技术相关的文章（中英文均可）。主要包括以下所列主题以及与此相关的专业范围：

1. 丝印，2. 贴片，3. 焊接，4. 微组装，5. 半导体，6. 印制板和焊盘设计，7. 焊点质量，8. 检测与返修，9. 检测标准，10. 机器人自动化，11. 材料选择，12. 设备改造，13. 清洗，14. 设备防护，15. 智能制造，16. 管理等

二、征文要求：

1. 论文保密审查由作者所在单位负责。

2. 征文截至日期及论文要求：

征文截止时间为 2019 年 9 月中旬，刊载通知于 10 月国庆前发出。论文以正式论文的形式（包括题目、作者姓名、作者单位、摘要、关键词、正文、参考文献）书写应征论文。

3. 论文提交：

WORD 格式，投稿采取采取电子邮件方式（shesmt@163.com 或 vivien.su@foxmail.com）。请接到通知后填写报题表，以传真或 Email 回复给专委会，有关具体开会时间届时会另行通知。感谢您的支持与合作。

联系地址：四川省电子学会 SMT 专委会 四川省成都市成华区建设北路二段 4 号电子科大通信大楼 508 室

联系人：苏 丽
传 真：028-83205986

联系电话：13518143895, 028-86513677, 13908188251,
E-mail: shcsmt@163.com vivien.su@foxmail.com



附件：

征文回执表

姓 名		邮 编	
单 位			
地 址			
电 话		传 真	
		手 机	
论文题目			
内容提要			